

Express5800/R120h-1E(2nd-Gen) スペック詳細

フレームモデル

2020/03/26 版

製品名称			Express5800/R120h-1E		
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	4x 3.5型ドライブモデル	
製品型名			N8100-2779Y	N8100-2780Y	
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90GHz, 8.25MB, TDP85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10GHz, 11MB, TDP85W) Silver 4210(10C/20T, 2.20GHz, 13.75MB, TDP85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20GHz, 16.50MB, TDP85W) Silver 4215(8C/16T, 2.50GHz, 11MB, TDP85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10GHz, 22MB, TDP100W) Gold 5215(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP85W), Gold 5217(8C/16T, 3GHz, 11MB, TDP115W) Gold 5218(16C/32T, 2.30GHz, 22MB, TDP125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20GHz, 24.75MB, TDP125W) Gold 5222(4C/8T, 3.80GHz, 16.50MB, TDP105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70GHz, 19.25MB, TDP125W) Gold 6230(20C/40T, 2.10GHz, 27.50MB, TDP125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30GHz, 24.75MB, TDP130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80GHz, 22MB, TDP150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10GHz, 35.75MB, TDP150W), Gold 6209U(20C/40T, 2.10GHz, 27.50MB, TDP125W), Gold 6210U(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W)			
		標準搭載数 / 最大搭載数			
		0/2			
		コントローラ・ハブとの接続			
		DMI3 (8GB/s)			
		インテル® 64			
		対応			
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー			
		対応			
		インテル® ハイバースレッディング・テクノロジー			
対応 (Xeon Bronze 3204は除く)					
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー					
対応 (Xeon Bronze 3204は除く)					
CPUソケット形状					
LGA3647					
ホットプラグ					
-					
冷却方式					
ファンなしヒートシンク					
チップセット					
インテル® C622チップセット					
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1TB (16x 64GB)			
	メモリソケット数	16			
	増設単位	1			
	搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB)			
	最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)			
	メモリバス帯域(チャネルあたり)	23.4GB/s			
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)			
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, DDDC, ADDDC			
	メモリスベアリング	対応			
	メモリミラーリング	対応			
	ホットプラグ	-			
	モジュールピン数	288 ピン			
	動作電圧	1.2V			
	バッファ機能	対応			
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ	4x3.5型ドライブ
			リア	2x2.5型増設ドライブ(オプション)	
		内蔵標準	-		
			-		
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 20TB (10x 2TB), SAS 24TB (10x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 38.4TB (10x 3.84TB), SAS SSD: 19.2TB (10x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 48TB(4x 12TB), ニアラインSAS 48TB(4x 12TB)
			ホットスワップ		対応
	インタフェース規格とRAID構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1		
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
	拡張ベイ		-		
拡張スロット	対応スロット	標準ライザなし 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
	グラフィック表示と解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用)			
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 2x データLANコネクタ (1000BASE-Tのみ対応 (RJ-45))*7 1x シリアルポート (オプション)			
		1x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0			
		内部	オンボード		
ネットワーク	実装形式	Intel C622 Chipset内蔵			
	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	チーミング	対応			
	FEC / GEC	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
	ジャンボフレーム	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
リモート	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	コントローラ	BMC			
マネージメント	マネージメント用ポート	Marvell PHY			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		対応			
キーボード / マウス		オプション			
BIOS Version (出荷当初)		System ROM U31 v2.04 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BMC Firmware Revision (出荷当初)		1.43(最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
System Sleep State		S0, S5			
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ不可)			
筐体デザイン		1Uラックマウント			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		434.6mm x 614.9mm x 42.9mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)			
質量 (最小 / 最大)		12kg / 25kg	13kg / 28kg		
電源	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159, 160) 500W/800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161) 800W 80 PLUS® Titanium取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)				
	消費電力(100V最大構成時, 最大電力)	908VA / 899W (800W電源最大値)			
	消費電力(200V最大構成時, 最大電力)	876VA / 867W (800W電源最大値)			
	発熱量	3237KJ/h			
	省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率	対象外	対象外		
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時)	28.2dBA / 38.9dBA			
測定方式		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *6, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
温度条件	VCCI クラス A				
湿度条件	Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware				
ハードウェア認証規定	スタートアップガイド, 保証書				
OS認証	3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)				
主な添付品	3年パーツ保証				
無償保証内容	-				
インストールOS	-				
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *3, Red Hat® Enterprise Linux® 8.0*8 VMware ESXi™ 6.5 Update2以降, VMware ESXi™ 6.7 Update2以降			
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			
動作確認OS *4		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			

ExpressSelectionPack

製品名称			ExpressSelectionPack	
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	
製品型名			NP8100-2779YP3Y	NP8100-2779YP2Y
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90GHz, 8.25MB, TDP85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10GHz, 11MB, TDP85W) Silver 4210(10C/20T, 2.20GHz, 13.75MB, TDP85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20GHz, 16.50MB, TDP85W) Silver 4215(8C/16T, 2.50GHz, 11MB, TDP85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10GHz, 22MB, TDP100W) Gold 5215(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP85W), Gold 5217(8C/16T, 3GHz, 11MB, TDP115W) Gold 5218(16C/32T, 2.30GHz, 22MB, TDP125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20GHz, 24.75MB, TDP125W) Gold 5222(4C/8T, 3.80GHz, 16.50MB, TDP105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70GHz, 19.25MB, TDP125W) Gold 6230(20C/40T, 2.10GHz, 27.50MB, TDP125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30GHz, 24.75MB, TDP130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80GHz, 22MB, TDP150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10GHz, 35.75MB, TDP150W), Gold 6209U(20C/40T, 2.10GHz, 27.50MB, TDP125W), Gold 6210U(20C/40T, 2.50GHz, 27.50MB, TDP150W)	
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2	
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)	
		インテル® 64	対応	
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	対応	
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	対応	
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応	
		CPUソケット形状	LGA3647	
		ホットプラグ	-	
冷却方式	ファンなしヒートシンク			
チップセット			インテル® C622チップセット	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1TB (16x 64GB)		
	メモリソケット数	16		
	増設単位	1		
	搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB)		
	最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)		
	メモリバス帯域(/チャンネルあたり)	19.2GB/s		
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, DDDC, ADDDC		
	メモリスベアリング	対応		
	メモリミラーリング	対応		
	ホットプラグ	-		
	モジュールピン数	288 ピン		
	動作電圧	1.2V		
バッファ機能	対応			
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ
			リア	2x2.5型増設ドライブ(オプション)
			内部	-
		内蔵標準		-
		内蔵最大		2.5型HDD: SATA 20TB (10x 2TB), SAS 24TB (10x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 38.4TB (10x 3.84TB), SAS SSD: 19.2TB (10x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)
		ホットスワップ		対応
	インタフェース規格とRAID構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1	
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2	
	拡張ベイ		-	
拡張スロット	対応スロット	標準ライザなし 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)		
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0		
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB		
	グラフィック表示と解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200		
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用) 2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 2x データLANコネクタ (1000BASE-Tのみ対応 (RJ-45))*7 1x シリアルポート (オプション)		
	リア	1 x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0		
	内部	オンボード		
	実装形式	Intel C622 Chipset内蔵		
ネットワーク	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)		
	チーミング	対応		
	FEC / GEC	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)		
	ジャンボフレーム	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応		
リモートマネージメント	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応		
	コントローラ	BMC		
マネージメント		Marvell PHY		
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)			対応	
キーボード / マウス			オプション	
BIOS Version (出荷当初)			System ROM U31 v2.04 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
BMC Firmware Revision (出荷当初)			1.43(最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
System Sleep State			S0, S5	
冗長電源			対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長ファン			対応 (オプション, ホットプラグ不可)	
筐体デザイン			1Uラックマウント	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)			434.6mm x 614.9mm x 42.9mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)	
質量 (最小 / 最大)			12kg / 25kg	
電源	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159, 160) 500W/800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161) 800W 80 PLUS® Titanium取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
	908VA / 899W (800W電源最大値)			
	876VA / 867W (800W電源最大値)			
	3237KJ/h			
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)			908VA / 899W (800W電源最大値)	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)			876VA / 867W (800W電源最大値)	
発熱量			3237KJ/h	
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率			対象外	
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時)	28.2dBA / 38.9dBA		
測定方式	ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *6, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
温度条件				
湿度条件				
ハードウェア認証規定			VCCI クラス A	
OS認証			Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware	
主な添付品			スタートアップガイド, 保証書	
無償保証内容			3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
インストールOS			Microsoft® Windows Server® 2016 Standard *5	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter,		
動作確認OS *4			最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います	

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
- *3 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *4 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *5 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2019のライセンス条項に同意していただく必要があります。詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2019/down.html> をご覧ください。
- *6 40°C/45°C環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40°C/45°C対応についての注意事項」をご参照ください。
- *7 100BASE-xx,10BASE-xは非対応です。
- *8 Red Hat Enterprise Linux 8.0を使用する場合は、弊社営業までお問い合わせください。